公司代码:688798　　公司简称:艾为电子

上海艾为电子技术股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	艾为电子	688798	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余美伊	余美伊
电话	021-52968068	021-52968068
办公地址	上海市闵行区秀文路908号B座15层	上海市闵行区秀文路908号B座15层
电子信箱	securities@awinic.com	securities@awinic.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,042,143,478.01	5,088,487,195.06	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	4,039,743,919.32	3,923,100,333.85	2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,369,558,110.54	1,581,449,032.03	-13.40
利润总额	152,784,081.67	84,306,894.87	81.22
归属于上市公司股东的净利润	156,521,550.89	91,486,648.21	71.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,832,448.30	67,536,219.64	81.88
经营活动产生的现金流量净额	78,752,102.51	20,919,305.46	276.46
加权平均净资产收益率(%)	3.91	2.48	增加1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.39	71.79
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.39	71.79
研发投入占营业收入的比例(%)	19.20	15.99	增加3.21个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	12,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孙洪军	境内自然人	41.80	97,448,396	97,385,396	97,385,396	无	0
郭辉	境内自然人	9.48	22,110,000	0	0	无	0
程剑涛	境内自然人	3.37	7,856,846	0	0	无	0
娄声波	境内自然人	2.92	6,802,657	0	0	无	0
上海支准企业管理中心(有限合伙)	其他	2.91	6,781,411	0	0	无	0
张忠	境内自然人	2.80	6,517,620	0	0	无	0
杜黎明	境内自然人	1.97	4,602,180	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.33	3,096,762	0	0	无	0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.15	2,672,713	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.10	2,575,066	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙洪军先生持有上海支准企业管理中心(有限合伙)0.24%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海支准企业管理中心(有限合伙)1.72%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2025-040

上海艾为电子技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2021[1953]号)核准,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A股)41,800,000股,发行价格为每股76.58元,募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元,扣除承销保荐费等发行费用(不含税)人民币165,782,585.36元后,实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)签订的承销协议,本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用(含税)合计人民币150,058,795.06元;本公司募集资金扣除承销保荐费用(含税)后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日止,本公司累计使用募集资金2,165,506,830.13元,其中以前年度累计使用募集资金1,827,235,012.00元,本年度使用募集资金338,271,818.13元,截至2025年6月30日止,本公司募集资金账户余额为163,051,907.75元,具体情况为:

明细	金额(元)
2025年1月1日募集资金账户余额	349,475,544.07
1.募集资金账户资金的增加项:	
(1)专户利息收入	903,928.16
(2)理财投资收益	3,946,381.74
(3)赎回理财产品	258,000,000.00
(4)定期存款到期	60,000,000.00
(5)归还部分临时补流	29,000,000.00
小计	351,850,309.90
2.募集资金账户资金的减少项:	
(1)直接投入募集资金投资项目的资金	338,271,818.13
(2)购买理财产品	200,000,000.00
(3)支付专户手续费支出等	2,128.09
小计	538,273,946.22
2025年6月30日募集资金专户余额	163,051,907.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》,并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年1月16日再次更新了《管理制度》,并于2024年2月5日经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过。同时,公司及保荐人于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》, 于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2025年1月23日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额(元)
招商银行上海分行营业部	121928744310666	募集专户	996,517.32
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	募集专户	26,496,530.46
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	募集专户	25,759,353.58
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	募集专户	19,740,011.13
上海银行闵行支行	03004644696	募集专户	18,454,220.80
上海银行闵行支行	03004644378	募集专户	68,536.57
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	募集专户	41,192,847.71
上海银行闵行支行	03005501767	募集专户	1,240,401.48
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	募集专户	29,103,439.46
招商银行上海分行营业部	121939323310118	募集专户	0.00
上海银行闵行支行	03005824825	募集专户	3.02
上海银行闵行支行	03005824795	募集专户	0.61
上海银行闵行支行	03005824817	募集专户	9.41
上海银行闵行支行	03005824787	募集专户	0.00
招商银行上海分行营业部	121941213410012	募集专户	3.42
招商银行上海分行营业部	121939330310013	募集专户	15.85
招商银行上海分行营业部	121944966010017	募集专户	3.71
招商银行上海分行营业部	121945865310018	募集专户	2.70
招商银行上海分行营业部	121953529210020	募集专户	0.33
招商银行上海分行营业部	411910565110021	募集专户	1.44
招商银行上海分行营业部	121980045910022	募集专户	8.75
合计			163,051,907.75

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月16日,本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2025年6月30日止,公司暂时补充流动资金尚未归还金额为57,100万元。截至2025年8月8日止,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年8月16日,本公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司募集资金使用效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日止,公司用于购买现金管理产品的期末余额为25,000万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

存放机构	产品名称	金额(元)	购买日	到期日	公司主体
申万证券	龙鼎定制1442期	50,000,000.00	2024/9/3	2025/7/28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	20,000,000.00	2025/3/25	2025/7/21	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	30,000,000.00	2025/4/29	2025/7/28	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025/5/27	2025/8/25	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2025/4/3	2025/7/30	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	14,000,000.00	2025/4/29	2025/7/28	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	25,000,000.00	2025/4/24	2025/7/23	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	21,000,000.00	2025/5/15	2025/8/13	上海艾为微电子技术有限公司
合计		250,000,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、募集资金使用过程中置换

2023年8月18日,本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况,采用集中采购和支付的方式,即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等,当月编制置换申请单,按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后,由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

2、其他募投项目调整

2025年1月16日,本公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司、上海艾为半导体技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、合肥艾为集成电路技术有限公司、哈尔滨艾为微电子技术有限公司、大连艾为微电子技术有限公司、北京艾为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“高性能模拟芯片研发和产业化项目”及“发展与科技储备资金”的实施主体。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2025年8月14日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司　　2025年半年度

单位:人民币元

募集资金总额			3,035,261,414.64	本年度投入募集资金总额					338,271,818.13
变更用途的募集资金总额			202,050,000.00	已累计投入募集资金总额					2,165,506,830.13
变更用途的募集资金总额比例			6.66%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能音频芯片研发和产业化项目	否	441,645,900.00	441,645,900.00	441,645,900.00	56,829,134.16	412,985,612.39	-28,660,287.61	93.51	2025年8月	不适用	不适用	否
5G射频器件研发和产业化项目	否	211,770,529.19	211,770,529.19	211,770,529.19	18,038,142.94	156,234,884.15	-55,535,645.04	73.78	2025年8月	不适用	不适用	否
马达驱动芯片研发和产业化项目	否	367,891,167.57	367,891,167.57	367,891,167.57	38,285,689.60	266,870,489.12	-101,020,678.45	72.54	2025年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	408,247,600.00	206,197,600.00	206,197,600.00	-	218,922,897.29	12,725,297.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否
电子工程测试中心建设项目	是	738,582,000.00	940,632,000.00	940,632,000.00	109,721,803.26	681,059,460.72	-259,572,539.28	72.40	2026年3月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	34,409,581.22	176,682,700.49	-123,317,299.51	58.89	2025年8月	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	567,124,217.88	100,044,003.51	100,044,003.51	-	100,044,003.51	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高性能模拟芯片研发和产业化项目	否		467,080,214.37	467,080,214.37	80,987,466.95	152,706,782.46	-314,373,431.91	32.69	2026年6月	不适用	不适用	否
合计		3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	3,035,261,414.64	338,271,818.13	2,165,506,830.13	-869,754,584.51					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不存在									
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司不存在项目可行性发生重大变化的情形									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不存在									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见说明三(三)									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见说明三(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不存在									
募集资金结余的金额及形成原因			不存在									
募集资金其他使用情况			详见说明三(八)									

注1:研发中心建设项目:截至期末累计投资金额超过承诺投资金额12,725,297.29元,投入进度超过100%,系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注2:2025年7月27日,本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》,由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化,公司对研发项目规划进行了调整,拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整,公司拟加大对55nm和40nm BCD先进工艺导入的投入,根据对未来投入规划的测算,将募投项目延期至2026年8月,以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。

注3:高性能模拟芯片研发和产业化项目:募集资金承诺投资总额467,080,214.37元不含首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注4:2025年8月12日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》,“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预订可使用状态日期为2026年6月,该项目包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发,项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点,随着细分市场竞争加剧,公司需要更多的时间分析最新市场需求,根据需求进一步升级迭代产品,以更好的适应市场变化,优化资源配置。同时,“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金200,755,731.09元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后,可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入和升级迭代。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后,将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司　　2025年半年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	940,632,000.00	940,632,000.00	109,721,803.26	681,059,460.72	72.40	2026年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	206,197,600.00	206,197,600.00	-	218,922,897.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否
合计		1,146,829,600.00	1,146,829,600.00	109,721,803.26	899,982,358.01					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高,需要配备大量高素质技术人员,同时建设测试生产线,提升公司芯片测试的产能,确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益,用于“电子工程测试中心建设项目”。 公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》,同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元,使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元,为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”,保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》(公告编号:2023-053)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		2024年4月8日,本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》,因外部环境变化,公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟,亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致开展征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求,设计单位重新对施工图进行调整修改,建设规模超过原先体量,项目新增设计两层地下室,整体施工周期增加,并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审,导致项目建设周期拉长,本项目投产时间也将随之顺延,董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预订可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		公司不存在项目可行性发生重大变化的情形								

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2025-043

上海艾为电子技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

2025年8月12日,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》。

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已完成并达到预定可使用状态,同意公司将“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”予以结项,并将节余募集资金投入募投项目“高性能模拟芯片研发和产业化项目”;同时,同意将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”进行延期。

保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1953号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,180万股,每股发行价格为76.58元,募集资金总额为人民币3,201,044,000元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	使用募集资金投入金额(万元)
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		246,813.72	246,813.72

公司分别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为47,747.45万元,拟使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益,剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	使用募集资金投入金额(万元)
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		47,747.45	47,220.00

公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》,同意对“研发中心建设项目”结项后,公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元,合计约20,183.60万元(具体金额以划拨日为准)用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”,并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元(具体金额以划拨日为准), 募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元 (具体金额以划拨日为准)。公司于2023年12月5号进行了划拨, 实际划拨金额为20,205.00万元, 实际投资总额变更为94,063.20万元。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

(一)募投项目结项的具体情况

公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已完成并达到预定可使用状态。截至2025年8月7日,本次结项募投项目的募集资金使用和节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额①	累计投入募集资金金额②	利息及理财收益(扣除手续费)③	节余募集资金金额④=①-②+③	预计尚需支付的募集资金余额
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	42,699.86	2,023.54	3,488.27	157.57
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	16,029.15	1,225.35	6,373.25	716.10
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	27,774.92	2,168.06	11,182.25	94.53

注:

1、实际“节余募集资金金额”以资金转出当日专户余额为准;

2、“预计尚需支付的募集资金金额”包含尚未支付的资产和光罩费,不足部分以自有资金支付,最终金额以项目实际支付为准;

3、所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

(二)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着节约、审慎使用、费用管控的原则,在保证募投项目质量和风险控制的前提下,加强了对募投项目中各环节费用的控制、监督和管理,有效降低了募投项目实施成本;此外公司通过闲置募集资金现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,增加了募集资金利息和理财收益,使得本次募集项目募集资金结余。

(三)节余募集资金使用计划

截至2025年8月7日,“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金合计为21,043.78万元,公司拟将结余募集资金扣除已签订合同待支付款项968.20万元后的20,075.57万元用于投入到“高性能模拟芯片研发和产业化项目”,以满足市场需求及公司研发目标,提高公司募集资金使用效率。

在相关募集资金专户注销前,“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付;待节余募集资金投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”事项完成且募集资金专户注销后,剩余待支付款项将以自有资金支付。节余募集资金全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

(四)本次募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,有利于公司合理优化资源配置,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的核心竞争力和经营能力,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于公司的长期发展规划及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期情况

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

`公司基于审慎性原则,结合目前募投项目的实际进展情况,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
高性能模拟芯片研发和产业化项目	2026年6月	2027年12月

(二)本次部分募投项目延期原因

“高性能模拟芯片研发和产业化项目” 包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发,项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点,随着细分市场竞争加剧,公司需要更多的时间分析最新市场需求,根据需求进一步升级迭代产品,以更好的适应市场变化,优化资源配置。同时,“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金20,075.57万元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后,可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入和升级迭代。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后,拟将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。

(三)保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注产业发展方向及市场环境变化,结合公司实际情况,积极优化资源配置,合理统筹,加强对募投项目的监督管理,保障募投项目按期完成。

(四)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

2025年8月12日,第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》,以5票同意、0 票反对、0票弃权的结果审核通过。

(二)监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:艾为电子本